



2013年7月31日

各位

会社名 三井金属鉱業株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 兼 COO 仙田 貞雄
(コード番号 5706 東証第一部)
問合せ先 総務部広報室 東野 健二
(TEL. 03-5437-8028)

キャリア付極薄電解銅箔の国内での増産について

～IC パッケージ回路基板用途、1.5～5.0 μ m 極薄電解銅箔を月産 140 万 m²体制へ～

当社 三井金属鉱業株式会社（東京都品川区）は、このたび IC パッケージ回路基板用途のキャリア付極薄電解銅箔 **MicroThin™** について、上尾事業所における生産能力をこれまでの月産 100 万 m² から 140 万 m² 体制へ増強することを決定し、設備増強工事を開始しました。

【MicroThin™ の増強の背景および需要動向】

当社の極薄電解銅箔「MicroThin™」は主にスマートフォン向けロジック半導体である「アプリケーションプロセッサ（以下 AP）」などのパッケージ基板用に使われております。スマートフォンの高機能化により半導体の高集積化が急速に進展しており、それに伴い、実装するパッケージ基板の微細化も急激に進んでおります。

当社の極薄電解銅箔「MicroThin™」は微細回路形成に適した 1.5 μ m, 2 μ m, 3 μ m, 5 μ m の銅箔厚みと、複数種類の微細な粗化処理とを組み合わせた製品です。1300mm までの広幅でロール出荷が出来るため、大判で加工されるお客様の生産性の向上に寄与できることを高くご評価いただき、需要は年々高まっております。

また、最先端の超微細回路用には極薄電解銅箔の表面に特殊なプライマー樹脂（※1）が薄くコーティングされた構造の「MFG シリーズ（※2）」をラインナップしております。すでに大手携帯メーカー向け AP に採用され、今後更なる需要の伸びが予想されております。

【今後の当社の対応】

スマートフォン向け半導体市場においては、更なる微細化と、生産量の拡大が予想されており、材料サプライヤーに対しては安定した品質、技術対応力、十分な供給能力が要求されております。当社ではお客様との緊密な連携により開発をスピードアップさせるためにも、旗艦工場である上尾事業所において設備増強工事をを行う事を決定いたしました。

設備増強工事は 2014 年 3 月に完了し、4 月より従来の月産 100 万 m²体制から 140 万 m²体制に移行する予定としております。またマレーシア工場に有している BCP ライン（※3）については、今後の更なる需要の伸びにあわせた稼働も視野に入れております。

本増産により急速な需要増に対応できると共に、さらに将来を見据えた新製品の開発を加速していく所存です。

なお、本件による当社当期業績予想への影響は軽微です。

(補足)

※1 プライマー樹脂

… 基材側の樹脂と化学的に密着させるための樹脂。当社のプライマー樹脂は各種基材との十分な密着性と、超微細回路の形成性を両立させていることが特徴。

※2 MFG シリーズ

… 極薄電解銅箔「MicroThin™」に 2 μ m 程度のプライマー樹脂を塗布した製品。回路形成方法の違いにあわせて銅箔・プライマー樹脂を最適化した 2 タイプを上市しております。

※3 BCP ライン

… 日本の拠点が稼働できない場合の BCP（事業継続計画）として、マレーシア工場内に設置した MicroThin™ のバックアップ製造ライン（2011 年 6 月 7 日リリースの「キャリア付極薄電解銅箔 MicroThin™ のバックアップ生産体制について」参照）

以 上